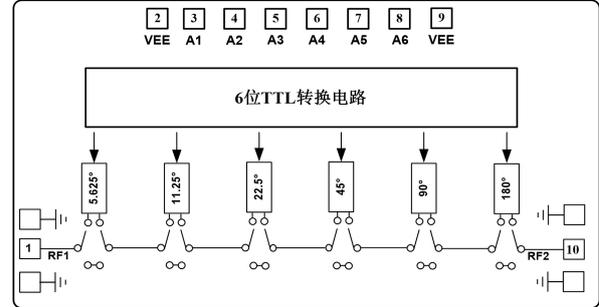




主要特点

- 移相范围: 360°
- 最小移相量: 5.625°
- 移相精度 RMS: 5°
- 插入损耗: 14 dB
- 移相幅度调制: ± 0.8 dB
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 2.0 × 3.5 × 0.1 mm³

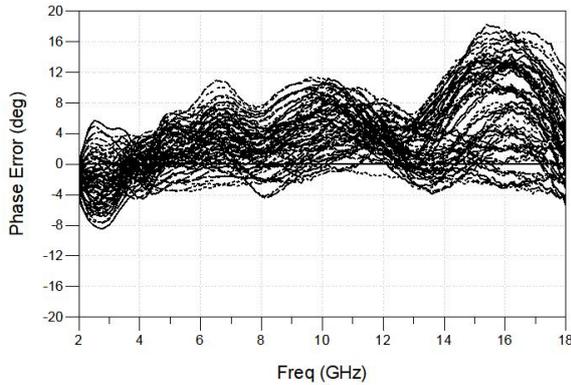
功能框图



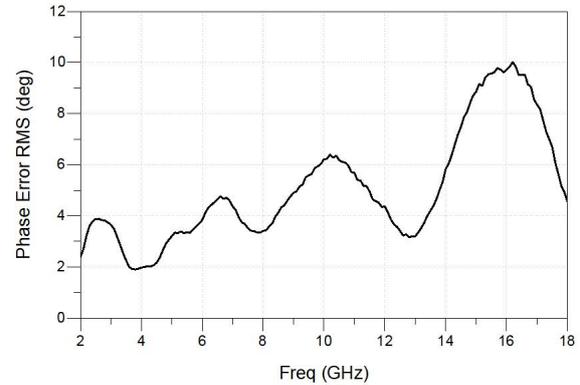
性能指标 ($T_A = +25^{\circ}\text{C}$, $VEE = -5\text{ V}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	2 - 18			GHz
插入损耗		14		dB
移相精度 RMS		5		°
移相幅度调制		±0.8		dB
回波损耗		10		dB
输入功率 1dB 压缩点		24		dBm
切换时间		20		ns

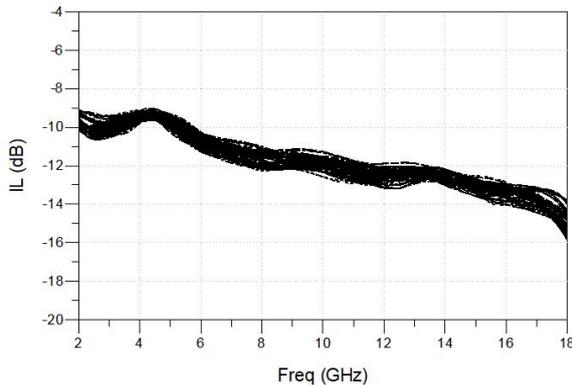
移相精度



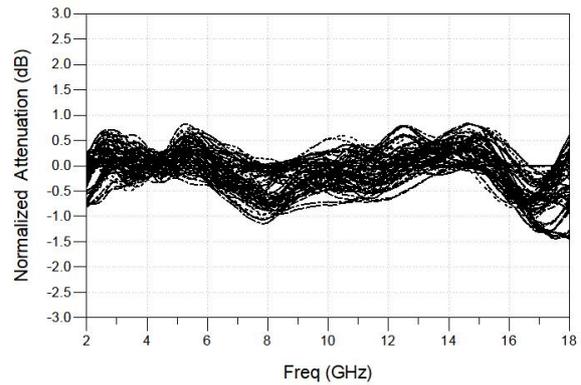
移相精度RMS



插入损耗

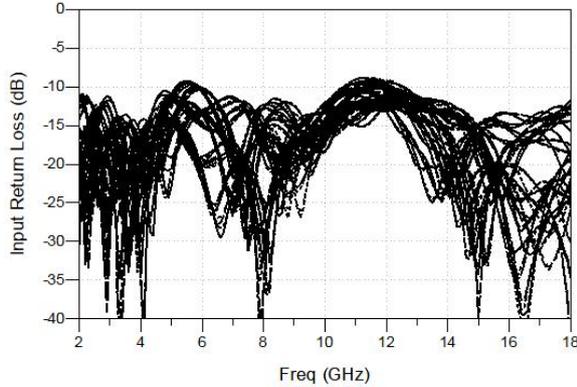


幅度调制

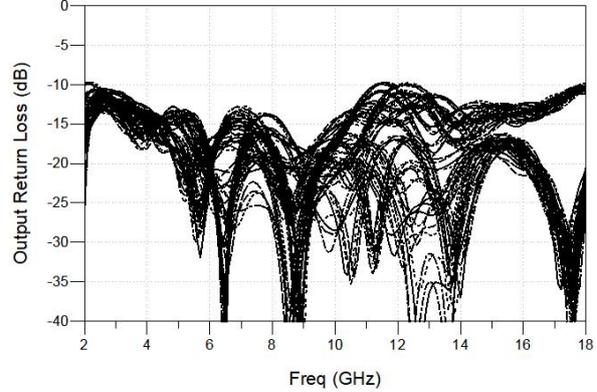




输入回波损耗

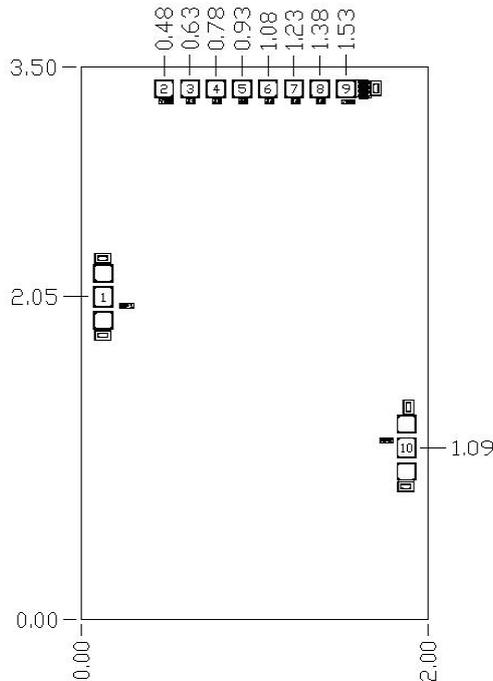


输出回波损耗



物理参数

单位: mm



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 10	RF1, RF2	该焊盘是射频端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm, 如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容
2, 9	VEE	该焊盘为电源端口, 任选一端接-5V
3-8	A1-A6	该焊盘为控制信号输入端口, 控制关系见真值表
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

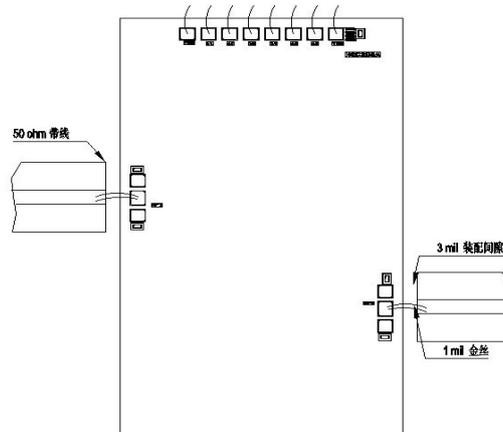


真值表

状态	5.625°	11.25°	22.5°	45°	90°	180°
	A1	A2	A3	A4	A5	A6
参考态	0	0	0	0	0	0
5.625°	1	0	0	0	0	0
11.25°	0	1	0	0	0	0
22.5°	0	0	1	0	0	0
45°	0	0	0	1	0	0
90°	0	0	0	0	1	0
180°	0	0	0	0	0	1

“0” 电平范围：0~0.8V；“1” 电平范围：2.3~5V

推荐装配图



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100um
3. 典型键合焊盘尺寸为 100*100um²
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN；厚度：0.6um
9. 控制输入端建议串联 1K 欧姆以上的保护电阻

极限参数

1. 射频输入功率：+24 dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150 °C
3. 工作温度：-55 ~ +85 °C